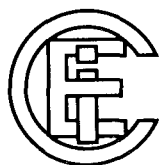


NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
191-5

Première édition
First edition
1987



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs

Cinquième partie: Recommandations applicables au transfert
automatique sur bande (TAB) des circuits intégrés

Mechanical standardization of semiconductor devices

Part 5: Recommendations applying to tape automated
bonding (TAB) of integrated circuits

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 617 de la CEI: Symboles graphiques pour schémas.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 617 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur le deuxième feuillet de la couverture, qui énumère les publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 617: Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 617, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

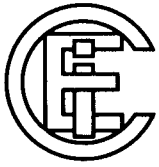
IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

CEI
IEC
191-5

Première édition
First edition
1987



Commission Electrotechnique Internationale

International Electrotechnical Commission

Международная Электротехническая Комиссия

Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs

Cinquième partie: Recommandations applicables au transfert
automatique sur bande (TAB) des circuits intégrés

Mechanical standardization of semiconductor devices

Part 5: Recommendations applying to tape automated
bonding (TAB) of integrated circuits

IEC 60191-5 Ed. 1.0 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

© CEI 1987 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

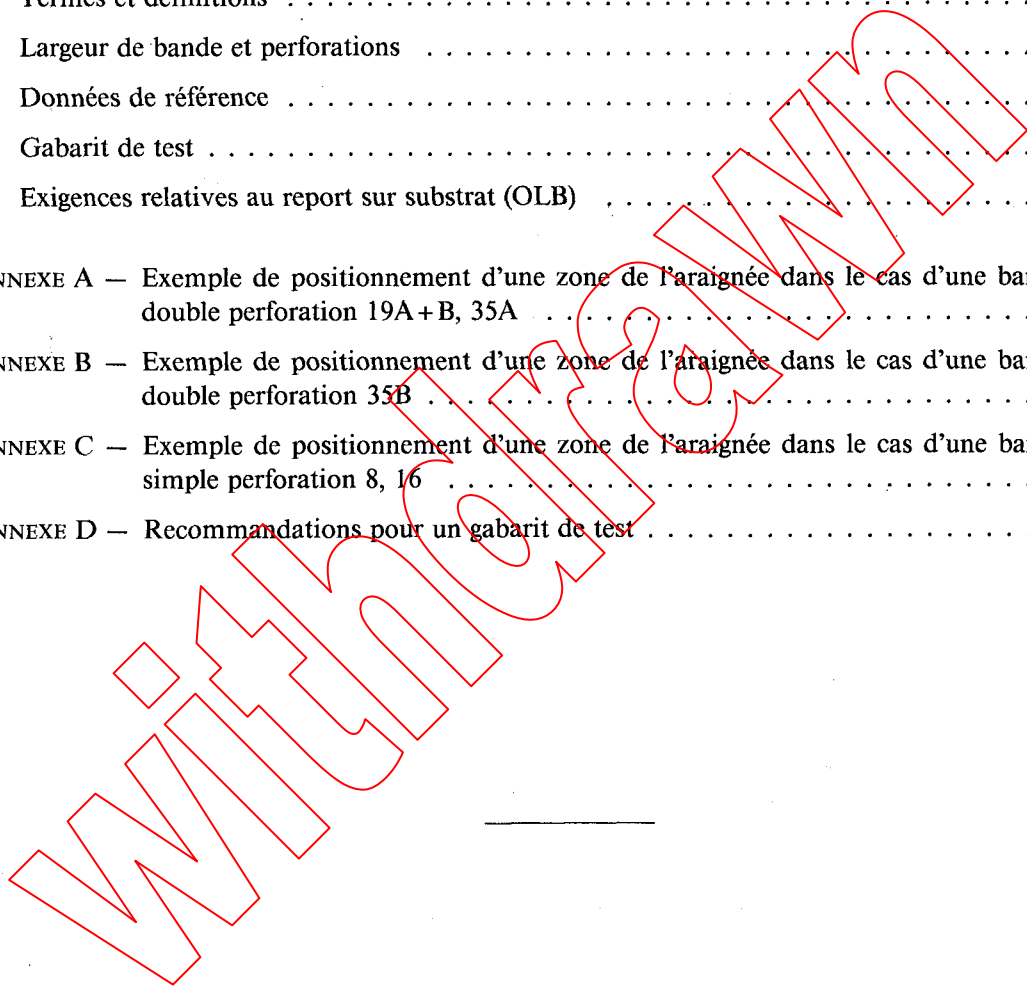
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
INTRODUCTION	6
Articles	
1. Domaine d'application	6
2. Termes et définitions	6
3. Largeur de bande et perforations	10
4. Données de référence	12
5. Gabarit de test	12
6. Exigences relatives au report sur substrat (OLB)	12
ANNEXE A — Exemple de positionnement d'une zone de l'araignée dans le cas d'une bande à double perforation 19A+B, 35A	16
ANNEXE B — Exemple de positionnement d'une zone de l'araignée dans le cas d'une bande à double perforation 35B	18
ANNEXE C — Exemple de positionnement d'une zone de l'araignée dans le cas d'une bande à simple perforation 8, 16	20
ANNEXE D — Recommandations pour un gabarit de test	22



CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
INTRODUCTION	7
Clause	
1. Scope	7
2. Terms and definitions	7
3. Tape width and perforations	11
4. Reference data	13
5. Test pattern	13
6. Outer lead bonding (OLB) requirements	13
APPENDIX A — Example of location of a spider zone: tape format with double perforation 19A + B, 35A	17
APPENDIX B — Example of location of a spider zone: tape format with double perforation 35B	19
APPENDIX C — Example of location of a spider zone: tape format with single perforation 8, 16	21
APPENDIX D — Recommendations for test probe pattern	23

